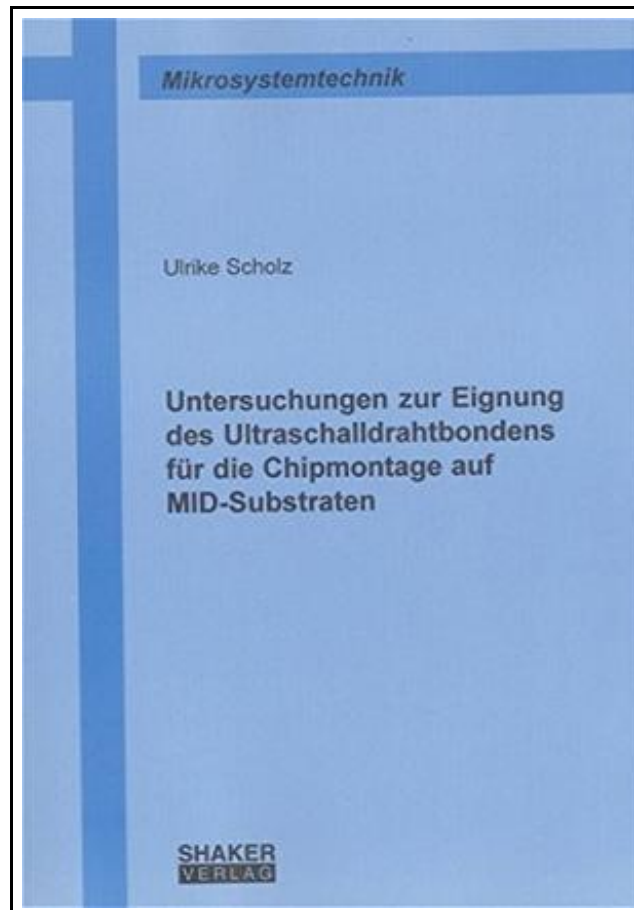


Untersuchungen zur Eignung des Ultraschalldrahtbondens für die Chipmontage auf MID- Substraten



Filesize: 2.48 MB

Reviews

It is an amazing publication which i actually have at any time go through. It really is writter in easy words and phrases rather than hard to understand. Its been developed in an extremely easy way which is merely following i finished reading through this pdf in which actually changed me, affect the way i think.

(Garry Lind)

UNTERSUCHUNGEN ZUR EIGNUNG DES ULTRASCHALLDRAHTBONDENS FÜR DIE CHIPMONTAGE AUF MID-SUBSTRATEN



To download **Untersuchungen zur Eignung des Ultraschalldrahtbondens für die Chipmontage auf MID-Substraten** eBook, you should refer to the hyperlink under and download the document or gain access to other information which might be highly relevant to **UNTERSUCHUNGEN ZUR EIGNUNG DES ULTRASCHALLDRAHTBONDENS FÜR DIE CHIPMONTAGE AUF MID-SUBSTRATEN** book.

Shaker Verlag Mrz 2004, 2004. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x151x15 mm. Neuware - Für Anwendungen der Mikrosystemtechnik (MEMS, MOEMS) werden insbesondere unter dem Gesichtspunkt der fortschreitenden Miniaturisierung zunehmend Molded Interconnect Devices (MIDs) als Substrate für die Chipmontage entwickelt. Diese Schaltungsträger unterscheiden sich hinsichtlich ihrer mechanischen Festigkeit, ihrer thermischen Belastbarkeit, ihrer Wärmeleitung, ihrer thermischen Ausdehnung sowie der Rauheit ihrer Leiterbahnen deutlich von herkömmlichen Substraten wie FR4 Leiterplatten, Keramikgehäusen oder Leadframes. Um herauszufinden, wie und unter welchen Bedingungen auch bei MIDs das Ultraschalldrahtbonden zur Kontaktierung von Nacktchips prozesssicher eingesetzt werden kann, wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurde vom Kenntnisstand zum Drahtbonden auf heute gebräuchlichen Substraten und den dabei zu berücksichtigenden Einflussfaktoren ausgegangen. Die experimentellen Untersuchungen wurden auf ganzflächig metallbeschichteten 1K-MIDs aus verschiedenen Polymerwerkstoffen (LCP, PA6, ABS/PC, PBT-MID) mit unterschiedlichen Metallschichten sowie auf 2K-MIDs aus LCP und auf laserstrukturierten 1K-MIDs aus LCP durchgeführt. Für die Herstellung der Metallschichten wurden außenstromlos chemische Abscheidung und PVD-Verfahren eingesetzt. Zum Bonden wurden AlSi1 Drähte mit unterschiedlichen Durchmessern und verschiedenen Festigkeiten verwendet. 174 pp. Deutsch.



Read Untersuchungen zur Eignung des Ultraschalldrahtbondens für die Chipmontage auf MID-Substraten Online



Download PDF Untersuchungen zur Eignung des Ultraschalldrahtbondens für die Chipmontage auf MID-Substraten

See Also



[PDF] Psychologisches Testverfahren

Follow the hyperlink under to read "Psychologisches Testverfahren" file.

[Read Document »](#)



[PDF] Programming in D

Follow the hyperlink under to read "Programming in D" file.

[Read Document »](#)



[PDF] Adobe Indesign CS/Cs2 Breakthroughs

Follow the hyperlink under to read "Adobe Indesign CS/Cs2 Breakthroughs" file.

[Read Document »](#)



[PDF] The Java Tutorial (3rd Edition)

Follow the hyperlink under to read "The Java Tutorial (3rd Edition)" file.

[Read Document »](#)



[PDF] Have You Locked the Castle Gate?

Follow the hyperlink under to read "Have You Locked the Castle Gate?" file.

[Read Document »](#)



[PDF] The Mystery on the Great Wall of China

Follow the hyperlink under to read "The Mystery on the Great Wall of China" file.

[Read Document »](#)